

Fourniture par TEAM de 8 wafers de polyimide 9 μm
pour chaque wafer :

- Enduction de résine et recuit sur plaque
- Transfert de motif à travers un masque par insolation UV
- Recuit post-induction et révélation grâce à un développeur spécifique
- Vérification des motifs de résine grâce à un microscope et à un profilomètre mécanique
- Dépôt Ti/Au de 50/200 sous vide
- Révélation par Lift Off
- Caractérisation des motifs
- Dépôt par Inkjet de solutions de nanoparticules

A prévoir également : Jeu de 3 masques Chrome/verre